

“衝撃に強い” 低融点 鉛フリーはんだ (新合金)

# TempSave B37



Sn-Bi 系はんだの弱点を改善

## 耐衝撃性向上

TempSave B37の特長

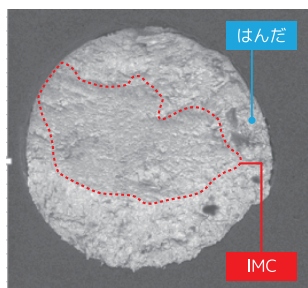
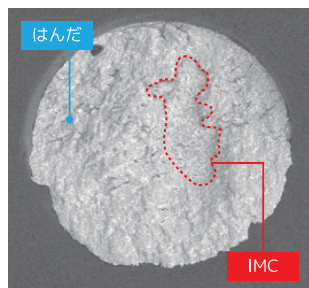
耐衝撃性向上    ボイド低減    ハロゲンフリー    ディップにも対応

初期の比較

**INITIAL** ボールシェア試験後の  
破断面SEM画像

TempSave B37

Sn-58Bi



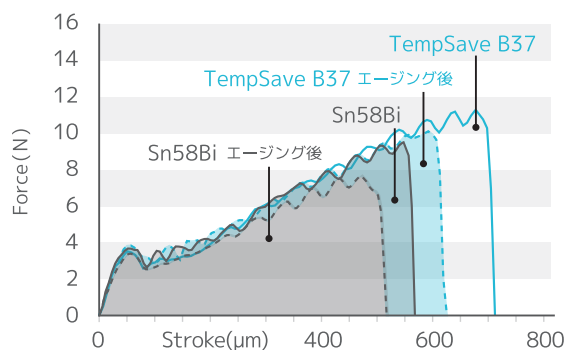
シエア方向



破断面に占めるはんだ領域の割合は「TempSaveB37」の方が大きく、応力吸収性に優れていることを示す。

エージング後の比較

**Aging** ボールシェア  
試験結果



高温エージング後においても「TempSaveB37」はその性能を高いレベルで保持。

上記データ、写真は特定条件下によるものです